

檔 號：

保存年限：

財團法人台灣設計研究院 函

機關地址：110台北市信義區光復南路133號
聯絡人：廖柏政
電話：2745-8199
電子信箱：pocheng_liao@tdri.org.tw

受文者：國立彰化師範大學

發文日期：中華民國111年7月15日

發文字號：台設字第1111002298號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(attch1 A095K0000Q0000000_1111002298-0-0.pdf)

主旨：敬邀貴校師生參與2022-2023「第九屆新一代設計產學合作」合作徵件及線上活動，請查照。

說明：

- 一、經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行2022-2023「第九屆新一代設計產學合作」，邀請各領域代表性企業單位參與出題，提供大專院校以上之設計相關科系學生報名。亦歡迎對主題有興趣的非設計系學生，與設計系學生組隊跨領域參與，進而學習企業需求，並有機會取得技術指導、模型補助、贊助獎金等資源，鼓勵所有不分科系的學生參與產學合作徵件比賽。
- 二、本年度徵件時間將於本(111)年8月29日起至10月3日下午5點截止，檢附本年度參賽徵件辦法及相關作業時程(如附件)。
- 三、因應新冠疫情，本屆「新一代設計產學合作」採線上辦理「產業趨勢暨題目分享」，以直播介紹產學合作專案，並邀請企業說明題目方向，讓有興趣的學生瞭解企業需求，同時吸收產業市場趨勢，誠摯邀請貴校師生報名參與，活動時間分別為7月19日、7月26日與8月3日，活動內容及報名資訊：<https://www.accupass.com/event/>

國立彰化師範大學

第1頁，共12頁



1110060758 111/07/18

2207100419024430354820，企業題目說明頁面：<https://reurl.cc/OAZp1X>。

四、相關問題請聯絡本案窗口陳悅慈專案經理或廖柏政專員，聯絡電話02-2745-8199轉分機658或657，聯絡信箱：yt_chen@tdri.org.tw 或 pocheng_liao@tdri.org.tw。

正本：國立清華大學、國立臺灣師範大學、國立成功大學、國立高雄師範大學、國立嘉義大學、國立高雄大學、國立東華大學、國立臺灣科技大學、國立雲林科技大學、國立屏東科技大學、國立臺北科技大學、國立臺北藝術大學、國立臺灣藝術大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、國立臺南大學、國立臺南藝術大學、國立臺北教育大學、國立臺中科技大學、國立臺中教育大學、國立臺北商業大學、國立屏東大學、國立高雄科技大學、國立臺東專科學校、東海大學、中原大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、逢甲大學、長庚大學、元智大學、中華大學學校財團法人中華大學、大葉大學、華梵大學、義守大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、朝陽科技大學、南華大學、大同大學、南臺學校財團法人南臺科技大學、崑山科技大學、樹德科技大學、龍華科技大學、長榮大學、健行學校財團法人健行科技大學、正修學校財團法人正修科技大學、萬能學校財團法人萬能科技大學、玄奘大學、建國科技大學、明志科技大學、高苑科技大學、大仁科技大學、聖約翰科技大學、嶺東科技大學、中國科技大學、亞洲大學、開南大學、佛光大學、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、遠東科技大學、景文科技大學、中華醫事科技大學、東南科技大學、德明財經科技大學、明道學校財團法人明道大學、南開科技大學、僑光科技大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、環球學校財團法人環球科技大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、修平學校財團法人修平科技大學、城市學校財團法人臺北城市科技大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、華夏學校財團法人華夏科技大學、致理學校財團法人致理科技大學、東方學校財團法人東方設計大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學、台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、亞東學校財團法人亞東科技大學、和春技術學院、南亞科技學校財團法人南亞技術學院、蘭陽技術學院、慈惠醫護管理專科學校、臺北市立大學、國立中山大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、國立政治大學、國立臺灣大學、國立陽明交通大學、國立臺灣海洋大學、國立中正大學、國立彰化師範大學、國立暨南國際大學、國立臺東大學、中國文化大學、靜宜大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、中臺科技大學、稻江科技暨管理學院、臺灣綜合大學系統、臺灣國立大學系統

副本：



新一代設計產學合作

yodex IAC yodex Industry-Academia Cooperation

2022-2023 第九屆新一代設計產學合作 參賽辦法

2022.05.27

一、計畫內容

經濟部工業局為建立產學實務連結機制，今(111)年推動 2022-2023 第九屆「新一代設計產學合作」，邀請科技、醫療、製造、福祉、設計等各領域具代表性企業或單位，以「創意發展型」及「議題解決型」兩大題目類型，提供大專以上設計相關科系學生產學合作課題。本專案將協助學生瞭解產業概況，徵選各校優秀團隊提案，協助入選團隊取得技術指導、模型補助、贊助獎金等資源進行設計產學合作，期待透過產業與學界相互交流，激盪出符合世界趨勢、兼具創意與實務的設計產學成果。

- 「創新發展型」企業題目：

期望學生針對產業未來趨勢以設計提出可能發展方向，產出之合作成果具前瞻創新性，有機會導入企業內部研發或長期進行發展。

- 「議題解決型」企業題目：

期望學生針對企業、產業或社會等既有議題及痛點以設計提出創新解決方案，產出之合作成果具實現可能，有機會於未來 2-5 年內導入實際應用。

二、計畫目的

期望透過產學合作，提供設計學生進入職場前產業概況、市場需求及製程技術等相關產業知識，以消弭學用落差，培養設計學生對產業實務之瞭解。同時鼓勵設計學生與不同專業領域之學生跨科系合作，透過產業多元化及跨校系與企業合作投件，培養未來跨領域多元人才，推動產業與學界互動合作之「新價值、新商業模式」。

三、辦理機關

- 指導單位：經濟部
- 主辦單位：經濟部工業局
- 執行單位：台灣設計研究院
- 參與出題企業/單位：



四、 參賽資格

- 國內設計相關科系(含產品、平面、視傳、多媒體、建築、空間、室內、時尚、工藝、文創等設計相關科系)在學學生，皆可報名。
- 上述科系學生，可依提案需求進行跨校、跨系、跨領域合作(例如資管、資工、電機、機械...等科系)。
- 可以個人或團隊形式報名參加，每組最多以 4 人為限、跨科系團隊最多 6 人。
- 跨科系學生需為設計科系之外修習其他非設計科系正式學位之學生，可包含雙主修、不包含輔系。
- 報名件數不限。
- 免報名費。

五、 注意事項

1. 學生可自行選擇有興趣之企業/團體等題目進行提案，且可同時針對 2 家以上企業進行提案。**但為保障多數學生參加產學合作機會，若決選後學生所屬團隊獲得超過 2 家以上企業錄取，每位學生最多僅能與 2 家不同企業題目進行產學合作。且若同一提案入圍 2 家以上企業錄取，僅能選擇 1 家企業進行合作。**
2. 關於產學專案介紹，請參考「新一代設計展官網」-「設計產學合作」
http://www.yodex.com.tw/intro_register
3. 111 年度產學企業出題及各題目詳細說明與智財權歸屬請參考題目公告網站
https://yodex.com.tw/enterprise_topic#enter-question
4. 產學合作企業/單位指導：由參與企業或單位每月至少安排 1 次設計指導、諮詢時間，由入圍團隊自行準備進度與討論，其餘參訪、工作營等多元型態之指導方式將依各企業資源及團隊表現情形彈性安排。
5. 結案皆需完成產學合作成果模型，並配合於明(112)年「新一代設計展」產學合作區進行展示及相關宣傳，展覽由設研院統籌規劃與執行。

六、 報名期間

111 年 8 月 29 日(星期一)至 10 月 3 日(星期一) 17 點 00 分 00 秒截止

(為避免網路塞車延誤報名時間，建議盡早完成報名。)

七、 活動時程 (主辦單位保有修改之權利)

年度	時程	內容
111	5 月 27 日(五)	企業出題公告
	8 月 29 日-10 月 3 日	受理報名與交件
	10 月 3 日(一)	17 點 00 分 00 秒 線上報名系統截止
	10 月 7 日-10 月 17 日	第一階段入圍團隊選拔—設計裱版審查

		(通過第一階段審查者，將通知出席第二階段簡報說明審查)
10月18日(暫)		第一階段入選團隊公告
10月19日-11月7日		第二階段入圍團隊選拔—簡報說明審查
11月11日-11月14日		產學入圍團隊公告與媒合期間
11月16日(暫)		產學期初交流大會(各出題企業與入圍團隊共同參加)
11月17日-12月31日		各企業產學交流參訪&諮詢指導活動
111	1月1日-4月30日	設計產學指導與交流期間(預計每月至少一次討論會議，實際討論次數依各組實際情況可彈性調整)
	1月1日-1月19日	產學期中會議(需與企業完成設計方向定案)
	4月1日-4月30日	產學期末評選(金獎、銀獎、銅獎選拔)
	5月(待確認)	設計產學成果展出(新一代設計展)

八、評選機制

1. 期初評選(入圍團隊選拔)

● 第一階段：書面資料審查

由評審委員依據上傳之設計圖面及書面電子檔進行線上審查，選出晉級第二階段之學生團隊。

● 第二階段：簡報說明審查

- 邀請晉級第二階段之學生團隊出席評選會議，針對作品設計提案概念進行簡報說明，並進行問答說明，各出題企業將選出 3-5 組入圍團隊參與後續產學合作與諮詢指導活動。(實際簡報審查時間通知將於入圍第一階段後另行通知)

2. 期末評選(企業金獎、銀獎、銅獎選拔)

入圍團隊與企業或單位進行產學合作後，預計於民國 112 年 4 月依據期末評選結果，決定金獎、銀獎、銅獎獲獎團隊各 1 組。

※實際入圍團隊及金銀銅獎團隊數量，將視實際成果及產學合作過程表現進行調整。各企業或團體保留獎項從缺之權利。

九、產學合作獎勵

各企業題目之模型補助及獎金有所不同，報名前請預先參考公告網站各出題詳細資訊

https://yodex.com.tw/enterprise_topic#enter-question

1. 模型補助費

- 各企業提供模型補助金額之上限依各命題企業或單位題目公告網站為準。
- 模型製作或相關材料補助費補助，申請時需提供收據或相關憑證。

2. 企業競賽獎金與獎狀

- 金獎團隊(預計各選出 1 隊)：金獎獎狀 1 紙，獎金依各命題企業或團體等提供為主。
- 銀獎團隊(預計各選出 1 隊)：銀獎獎狀 1 紙，獎金依各命題企業或團體等提供為主。
- 銅獎團隊(預計各選出 1 隊)：銅獎獎狀 1 紙，獎金依各命題企業或團體等提供為主。
- 針對未入選金銀銅獎之團隊：可獲得入圍獎狀 1 紙

※實際入圍團隊及金銀銅獎團隊數量將視參賽作品成果及產學合作過程表現進行調整，各企業或團體等保留獎項從缺之權利。

3. 交通費

為鼓勵入圍團隊積極參與產學合作活動，將提供團隊成員赴外縣市與企業或團體等進行討論之高鐵、台鐵、客運、機捷交通費補貼(限當天往返)，以高鐵一般票及台鐵自強號為申請上限，申請時需提供車票正本，並簽署收據。(計程車、公車等不在補助範圍之列)

十、報名方式

1. 一律採線上報名

- 請於截止時間前於網路報名並完成資料上傳。(預計 8 月 29 日開放報名)
- 報名系統網址：<https://tdri.surveycake.biz/s/l6d6p>
(※為避免網路塞車問題造成延誤，建議盡早完成報名。)
- 報名完成後，系統將自動發送「報名完成確認通知」至參賽者聯絡人之電子郵件信箱。若報名資料有問題，將額外以電子郵件方式個別通知報名者。
- 線上報名截止時間：111 年 10 月 3 日(一)17 點 00 分 00 秒截止(逾時恕不受理)。若未收到「報名完成確認通知」mail 請與主辦單位聯繫確認是否報名成功。



2. 上傳參賽作品檔案及相關文件電子檔 (每個檔案上限皆為 10mb)

(1) 設計提案內容：

- 提供內容：以「設計提案裱板」及「設計概念說明簡報」方式提供書面資料。
- 「設計提案裱板」繳交規格：
 - 呈現內容：應包含設計圖、設計概念說明等相關資訊，排版方式與字數不限。
 - 提供尺寸：以 A2 尺寸(594mm×420mm)「橫式」裱版呈現，每案裱版最多 2 張。
 - 檔名格式：檔名依據「投件企業名稱-作品名稱-編號」規則命名上傳(如「智○光電-OO 智慧系統-p1」、「智○光電-OO 智慧系統-p2」)。格式統一為 jpg 檔，解析度 dpi 150 以上，檔案大小至多 10MB。
- 「設計概念說明簡報」繳交規格：
 - 呈現內容：需包含但不僅限於團隊介紹、問題情境探索、設計概念說明、後續專案時程規劃等相關資訊，排版方式與字數不限。
 - 提供規格：請以 Powerpoint 或 PDF 檔案格式提供。不含封面及封底，頁數以 10 頁為上限。每案最多提供 1 份檔案。
 - 檔名格式：檔名依據「投件企業名稱-作品名稱」規則命名上傳(如「智○光電-OO 智慧系統」)。格式統一為 Powerpoint 或 PDF 檔案。

(2) 著作授權同意書(附件 1)：

需親筆簽名後提供掃描 PDF 檔，一件提案作品僅需繳交一份。檔案命名格式為「**著作授權書-企業名稱-作品名稱**」(EX: 著作授權書-喬 O 光電-OO 智慧系統)。因應 COVID-19 新冠肺炎疫情影響，若多人團隊成員無法以親筆簽名完成簽署，可接受以「手寫電子簽名」方式取代之。

(3) 個資使用同意書(附件 2)：

如以團體單位報名，則每人皆需完成親筆簽名，團隊成員可簽在同一張，簽署後提供掃描 jpg 檔，一件提案作品僅需繳交一份。檔案命名格式為「**個資同意書-企業名稱-作品名稱**」。(EX: 個資同意書-喬 O 光電-OO 智慧系統)。因應 COVID-19 新冠肺炎疫情影響，若多人團隊成員無法以親筆簽名完成簽署，可接受以「手寫電子簽名」方式取代之。

(4) 指導老師同意書(附件 3)：

親筆簽名後提供掃描 jpg 檔，一件提案作品僅需繳交一張。檔案命名格式為「**指導老師同意書-企業名稱-作品名稱**」。(EX: 指導老師同意書-喬 O 光電-OO 智慧系統)。因應 COVID-19 新冠肺炎疫情影響，若團隊成員或老師無法以親筆簽名完成簽署，可接受以「手寫電子簽名」方式取代之。

十一、聯絡資訊

台灣設計研究院「新一代設計產學合作」工作小組

110 台北市信義區光復南路 133 號 2 樓(松山文創園區)

TEL：02-2745-8199

分機 657 廖先生 pocheng_liao@tdri.org.tw

分機 658 陳小姐 yt_chen@tdri.org.tw

分機 542 劉小姐 hsunting_liu@tdri.org.tw

附件檔案

[附件 1、著作授權使用同意書](#)

[附件 2、個人資料蒐集、處理及利用同意書](#)

[附件 3、指導老師同意書](#)

[附件 4、線上報名系統填寫欄位參考](#)

財團法人台灣設計研究院 著作授權使用同意書

提案企業：

提案作品名稱：

學生/團隊姓名：

一、立書人同意將該作品以無償及非專屬方式，授權財團法人台灣設計研究院不限時、地、次數作下述非營利性質之利用：

1. 以紙本或數位方式出版。
2. 公開展示、重製、透過網路公開傳輸等用。
3. 配合宣傳推廣將作品納入資料庫。
4. 為符合財團法人台灣設計研究院業務需求，得將作品進行合理之格式變更。

二、授權之著作內容：

本作品內容如下列圖示所示（創作完成日期為民國 年 月 日）：

(授權內容圖示、照片檔案)

授權內容與作品簡述(至多 500 字)：

三、立書人保證該作品為其自行創作，有權為本同意書之各項授權，絕無侵害他人智慧財產權；若有侵權情事或相關糾紛，由立書人自行負責。立書人另承諾該作品未曾發表於任何媒體或參與比賽。

四、該作品若為二人以上共同著作，由全體著作人簽署。若由其中一位著作人代表簽署時，代表簽署之著作人保證已通知其他共同著作人，並經各共同著作人全體同意授權代為簽署本同意書。

五、為協助報名參與者進行作品智財權運用及各項後續推廣，立書人同意後續配合參與台灣設計研究院辦理之產學交流媒合相關事宜。

此致

財團法人台灣設計研究院

立書人(著作人)姓名(簽/章): _____

身分證字號: _____

電話號碼: _____

電子郵件信箱: _____

通訊地址: _____

中 華 民 國 年 月 日

附件二

財團法人台灣設計研究院 個人資料蒐集、處理及利用同意書

財團法人台灣設計研究院(以下簡稱本院)為執行經濟部工業局委辦 111 年設計驅動跨域整合創新計畫，並將蒐集、處理及利用您的個人資料，謹依據個人資料保護法(以下簡稱個資法)告知下列事項：

- 一、蒐集目的：本院依「個資法之特定目的及個人資料之類別」內「第 69 類-契約、類似契約或其他法律關係事務」與「第 172 類-其他公共部門(包括行政法人、政府捐助財團法人及其他公法人)執行相關業務」之目的，蒐集、處理及利用您的個人資料。
- 二、資料類別：自然人之姓名、職業、聯絡方式(包括但不限於電話號碼、E-mail、居住或工作地址)、其他得以直接或間接方式識別該個人之資料。(註:實際蒐集狀況請再修改本條內容文字)
- 三、利用期間：自 111 年 6 月 15 日開始，以合理方式利用至蒐集目的消失為止。
- 四、利用地區：除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，僅於中華民國領域內利用您的個人資料。
- 五、利用對象：本院與經濟部工業局。
- 六、利用方式：在不違反蒐集目的前提下，以網際網路、電子郵件、書面、傳真、國際傳輸行為及其他合法方式使用之。
- 七、當事人權利：您可依個人資料保護法第 3 條規定，就您的個人資料進行以下權利，如欲行使以下權利，請洽主執行單位專請洽本院專線(02)2745-8199#542 或來信至以下 hsunting_liu@tdri.org.tw。
 1. 查詢或請求閱覽
 2. 請求製給複製本
 3. 請求補充或更正
 4. 請求停止蒐集、處理或利用
 5. 請求刪除您的個人資料。
- 八、不提供個人資料之權益影響：若您未提供正確資訊或拒提供個資，本院將無法為您提供本計畫之相關服務。
- 九、本院因業務需要而委託其他單位處理您的個人資料時，將善盡監督之責。
- 十、您已瞭解本同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，並同意本院留存紙本以利查驗。

個人資料之同意提供：

- 一、本人已充分獲知且已瞭解上述告知事項。
- 二、本人同意於所列蒐集目的之必要範圍內，蒐集、處理及利用本人之個人資料。

學校/科系：_____

立書人：_____ (簽名)

聯絡電話：_____

中華民國 年 月 日

附件三

2022-2023 第九屆新一代設計產學合作專案
指導老師同意書

提案出題企業：

提案作品名稱：

學生/團隊姓名：

本人了解並同意指導學生參與 2022-2023 第九屆新一代設計產學合作專案，若其作品入選為入圍團隊，本人將於活動期間全力支持學生參與，敦促其遵守活動期間之相關規定，並配合提供相關必要之協助以產出設計成果。

此致

財團法人台灣設計研究院

學校科系：

指導老師： (簽名)

聯絡地址：

Email 信箱：

聯絡電話：

中 華 民 國 年 月 日

2022-2023 第九屆新一代設計產學合作專案 線上報名系統填寫欄位參考

1.選擇欲報名的出題企業及題目
<input type="checkbox"/> 惠生大藥局《設計貼近「銀髮需求」及中生代延伸性的創新體驗服務設計》 <input type="checkbox"/> 智晶光電股份有限公司 X 台灣博迪股份有限公司《創造 S.PAPA 新品牌創新科技互動產品/體驗》 <input type="checkbox"/> 春池玻璃實業有限公司 (W 春池計畫)《尋找循環材料打造永續生活》 <input type="checkbox"/> 德立斯科技股份有限公司《創新 IOT 之交通互動設計》 <input type="checkbox"/> 三陽工業股份有限公司 X 浩漢產品設計股份有限公司《以產品設計為學齡兒童創造 STEAM 教育體驗式教具/玩具》 <input type="checkbox"/> 財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會《如何透過設計，創造 6-18 歲兒童與青少年和身邊的大人平等對話的體驗》 <input type="checkbox"/> 台灣日立江森自控股份有限公司《如何重新定義新型態「浴廁場所」空調製品並創造美好的體感氛圍》 <input type="checkbox"/> 威剛科技股份有限公司《Innovating the Future 未來，由我們定義！》 <input type="checkbox"/> 建大工業股份有限公司 x 2023 KENDA DESIGN AWARD《KENDA-未來交通與輪胎的創新關係》
2.作品名稱
3.設計特點摘要說明(500 字內)
4.參賽者資料填寫-學校與科系
5.參賽成員名單
6.指導老師姓名
7.主要聯絡人資訊(姓名、E-MAIL、手機)
8.上傳作品資料及簽名文件電子檔(每個檔案上限 10mb) (設計提案裱版、設計概念說明、著作授權同意書、個資使用同意書、指導老師同意書)

※完成資料填寫後請務必按下「送出」才算完成報名。報名完成後，系統將自動發送「報名完成確認通知」至參賽者聯絡人之電子郵件信箱。若報名資料有問題，將額外以電子郵件方式個別通知報名者。